

گوشی تاشو می میکس فولد شیائومی از سیستم انتقال گرما فوق‌العاده‌ای برخوردار است - دیجیاتو

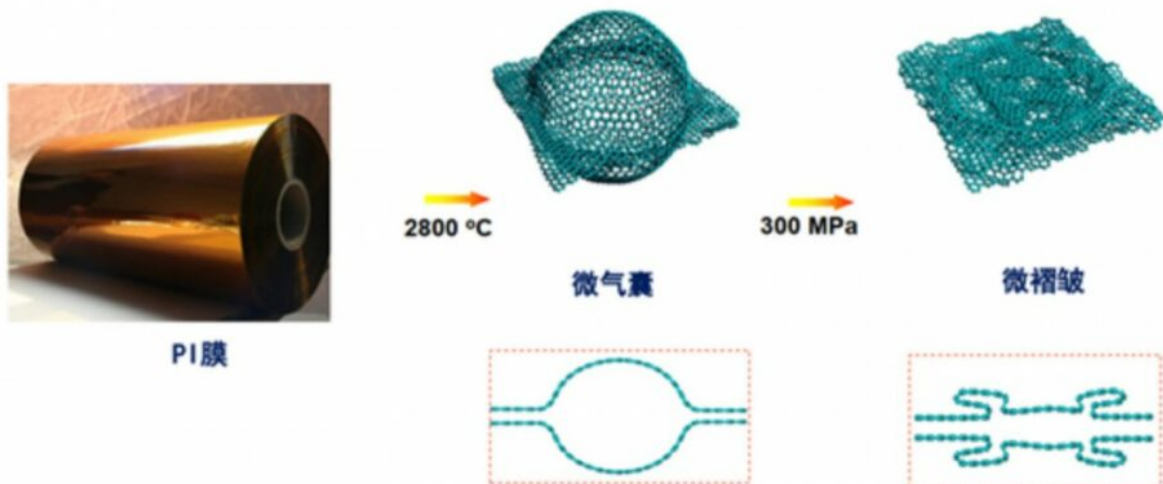
جواد تاجی | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

با وجودی که برخی گوشی‌های هوشمند کماکان از مشکل داغ شدن بیش از حد رنج می‌برند، شیائومی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی چینی ویبو در مورد راهکار خود برای حل مشکل گوشی‌های تاشو خبر داد.

یکی از موضوعاتی که در مورد موبایل‌های تاشو مطرح می‌شود، قابلیت کنترل گرما است که شرکت‌های تولید کننده گوشی‌های تاشو به آن توجه نشان می‌دهند.

شیائومی در اولین گوشی تاشو خود [می میکس فولد](#) نوعی مکانیزم انتقال حرارت موسوم به سیستم Butterfly ایجاد کرده است که می‌تواند گرما را از یک سمت گوشی به سمت دیگر انتقال دهد. در نتیجه سیستم خنک کننده این مدل، نسبت به گوشی‌هایی که تاشو نیستند [بسیار بزرگتر خواهد بود](#).

طبق گفته شیائومی می میکس فولد به لوکس‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های انتقال حرارت مجهز شده است. همچنین این گوشی هوشمند برای انتقال گرما از خنک کننده مایع، ژل حرارتی، ورقه‌های گرافیت چند لایه، ورقه‌های گرافیت مقاوم در برابر خم شدن و یک قطعه فویل مسی نیز استفاده می‌کند. با به علاوه می میکس فولد در مجموع از حدود ۲۲۶ سانتی‌متر مربع سطح مربوط به انتقال حرارت برخوردار است.



فرایند مورد نیاز برای خم شدن گرافیت

شیائومی برای ارتباط بین دو سمت گوشی با استفاده از گرافیت مقاوم در برابر خمش، یک تونل انتقال حرارتی ایجاد کرده است. مقاومت در برابر خمش گرافیت با وجود پوسته قرار گرفته در جنس آن حاصل می‌شود که با وجود خم شدن همچنان گرما را از خود عبور می‌دهد. به گفته شیائومی این ماده پس از ۲۰۰ هزار دفعه خم شدن فقط ۳ تا ۵ درصد از توانایی انتقال گرما خود را از دست می‌دهد.

می میکس فولد، گوشی تاشوی جدید شیائومی از چیپست اسنپدراگون ۸۸۸، صفحه نمایش بیرونی ۶.۵۲ اینچی و صفحه نمایش تاشو داخلی ۸.۰۱ اینچی بهره می‌برد. باتری این گوشی ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که از شارژ سریع ۶۷ وات پشتیبانی می‌کند. در ماژول دوربین این گوشی یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی قرار گرفته است.

[دیجیاتو](#)